

# 华茂翔锡球

产品名称	华茂翔锡球
公司名称	深圳市华茂翔电子有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌:华茂翔
公司地址	深圳市宝安区西乡三围宝安大道5001号沙边工业区A栋4楼B
联系电话	0755 - 29181122 13631672718

## 产品详情

### 锡球的种类

普通焊锡球(Sn的含量从2[%]-100[%], 熔点温度范围为182 ~ 316 ) ; 含Ag焊锡球(常见的产品含Ag量为1.5[%]、2[%]或3[%], 熔点温度在178 ~ 189 ) ; 低温焊锡球(含铋或铟类, 熔点温度为95 ~ 135 ) ; 高温焊锡球(熔点为186 ~ 309 ) ; 耐疲劳高纯度焊锡球(常见产品的熔点为178 和183 ) ; 无铅焊锡球(成分中的铅含量要小于0.1[%])。

VCM、CCM专用的黑胶、焊锡膏类(温度分有:中温、高温、低温;粉颗粒为3号、5号)倒装芯片固晶锡膏类(粉颗粒有:5号、6号、7号)

### 锡球的应用

锡球的应用有两类,一类应用是将一级互连的倒芯片(FC)直接安装到所用的场合,锡球在晶圆裁成芯片后直接接合在裸装的芯片上,在FC-BGA封装中起到芯片与封装基板电气互连的作用;另一类应用是二级互连焊接,该应用通过专用设备将微小的锡球一粒一粒地植入到封装基板上,通过加热锡球与基板上的连接盘接合。在IC封装(BGA、CSP等)中,芯片与母板进行焊接时,是通过回流焊炉的加热而实现的。

### 锡球的制造工艺

锡球的制造工艺普遍采用两种,即定量裁切法和真空喷雾法。前者对直径较大的焊球较适用,后者更适用于小直径焊球,也可用于较大直径焊球。对锡球的物理、电气性能要求主要有密度、固化点、热膨胀系数、凝固时体积改变率、比热、热导率、电导率、电阻率、表面张力、抗拉强度、抗疲劳寿命及延伸率等。除此以外,锡球的直径公差、真圆度、含氧量也被看作是目前锡球质量水平竞争的关键指标。